

# 电子

## Q2 本土智能手机同比需求好转,关注半导体设备龙头低估机会-半导体周跟踪

### 投资要点:

中美博弈或对股市产生影响,静待中报业绩期。(1) 美股半导体: 本周费城半导体指数跌幅为-3.1%, 或受到中美博弈影响, 美股相关半导体产业链或存在风险。(2) A 股半导体: 本周申万半导体-6.4%, 临近中报业绩期, 或存在对业绩不确定性的避险心理。各细分板块本周均出现回调, 设备、材料、封测、数字、模拟板块分别-6.6%/-5.7%/-7.5%/-7.1%/-6.0%, 跌幅较为平均。而拉长至一个月维度来看, 模拟跌幅较大, 为-7.5%。与之对应, 本月 A 股半导体成交额占比与 6 月相比有所回落, 截至本周五(0726) 已降至 5%。估值方面, 本周各板块亦有下挫。截至 7.26 日收盘, 材料、设备、封测、设计板块 PE (对应次年) 分别为 38、38、21、40 倍。

Q2 中国大陆智能手机出货量同比+10%, 关注国内消费需求好转。24Q2, 中国大陆智能手机市场回暖明显, 出货量同比增长 10%, 重回 7000 万台。中国本土厂商首次包揽前五席——vivo 凭稳固线下渠道及捕捉“618”需求, 出货量达 1310 万台, 以 19% 份额重回榜首。OPPO、荣耀分别以 1130 万台、1070 万台出货量位列二、三。华为 24Q3 同 24Q2 相比增速放缓, 以 1060 万台出货量居第四。小米通过新品发布提升曝光, K70 与 14 系列强劲, 出货量达 1000 万台, 同比增长 17%, 重回前五。苹果退至第六, 市场份额同比略降 2%。据 Canalys, 本土厂商首次包揽前五, 高端化战略与本土供应链协同成效显著。我们看好本土厂商的市场表现和市场领导地位, 为上游 IC 产业链标的提供更大成长空间, 建议持续关注消费电子 IC 标的。

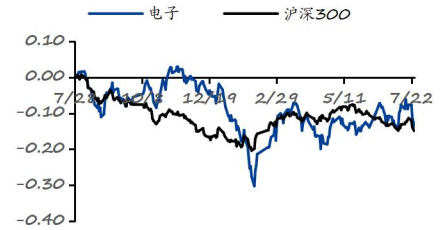
半导体设备行业内生增长动力依然强劲, HBM 加速竞争。SEMI 预测, 全球半导体制造设备销售额将在 2024 年增长至 1090 亿美元, 2025 年进一步增长至 1280 亿美元, 同比增长约 17%。这一增长受人工智能需求推动, 尤其是中国对设备支出的强劲贡献, 以及对 DRAM 和 HBM 等技术的投资增加。HBM 赛道白热化竞争或持续带动设备需求。SK Hynix 将在向主要客户提供样品后, 于 24Q3 开始量产 12 层 HBM3E, 并预计在 24Q4 向客户发货。三星电子的 HBM3 内存芯片也通过 NVIDIA 认证, 预计 8 月认证完成, 24Q3 实现供货。据 TrendForce, 预估 DRAM 及 NAND Flash 产业 2024 年营收年增幅度将分别增加 75%/77%。而 2025 年同比增速预计达到 51%/29%。

### 半导体板块跟踪:

数字: CPU/GPU——本周除龙芯中科+0.8%外, 其余均出现不同程度的回调, 其中海光信息-5.0%, 寒武纪-6.6%。但是周内重磅利好出现——受益于“领跑者”评价要求对于能效比的限制政策, 本周三单日寒武纪+5.15%, 海光信息+0.19%, 龙芯中科+0.71%, 在美国加紧出口限制下, 我们认为国产 CPU/GPU 将面临重大机遇。本周龙芯服务器 CPU 新品有所进展, 单硅片 16 核 32 线程的龙芯 3C6000 已完成流片。该处理器将首次引入龙链 1.0, 实现片间互连, 成倍降低片间访问延迟。与龙芯 3C5000 相比, 龙芯 3C6000 通用处理性能成倍提升, 已达到英特尔公司推出的中高端产品至强 (Xeon) Silver 4314 (发布于 2021 年 4 月) 处理器水平。此前, 龙芯 23Q4 重磅推出 PC 端 CPU 产品 3A6000, 已实现对酷睿十代对标(发布于 2020 年 5 月)。SoC——本周板块回调较为普遍, 相对而言, SoC 几大龙头公司回调幅度较小, 晶晨股份-5.7%, 恒玄科技-6.3%, 乐鑫科技-6.5%; 进入七月份以来, 晶晨股份/恒玄科技/乐鑫科技月度涨幅分别为+7.2%/+11%/+6.1%。我们依然坚定看好 SoC 龙头利润释放带来的业绩弹性。

## 强于大市 (维持评级)

### 一年内行业相对大盘走势



### 团队成员

分析师: 陈海进(S0210524060003)  
chj30590@hfzq.com.cn  
分析师: 徐巡(S0210524060004)  
xx30511@hfzq.com.cn  
联系人: 谢文嘉(S0210124040078)  
xwj30510@hfzq.com.cn  
联系人: 李雅文(S0210124040076)  
lyw30508@hfzq.com.cn

### 相关报告

- 短期波动不改终端创新浪潮, 大陆果链重要性进一步提升——消费电子系列跟踪——2024.07.27
- 国产算力芯片大机遇来临, 谷歌 Q2 云业务亮眼资本开支强劲-算力周跟踪——2024.07.25
- 重申自主可控链, 重视设备&算力等核心板块机遇-半导体周报——2024.07.21



| **存储**：本周存储板块整体下跌，跌幅最大的为聚辰股份，达-18.9%。此外，普冉股份-15.5%，江波龙-13.5%，兆易创新-12.1%，佰维存储-10%。SK海力士第二季度实现营收16万亿韩元，营业利润5.5万亿韩元（营业利润率为33%），净利润4.1万亿韩元（净利润率为25%）。季度营收创历史新高，远超2022年第二季度13.811万亿韩元的纪录。该公司表示，受惠于DRAM及NAND产品整体价格持续上涨，加上HBM等AI存储器需求旺盛，营收较上一季增长32%，加上高端产品销量上升及汇率影响，第二季营业利润率较上一季增加10%至33%。我们认为海力士营收再创新高，主要得益于HBM贡献巨大营收增量与传统存储业务价格提升拉动，存储周期持续向上。

| **模拟**：本周模拟板块行情较为分化，臻镭科技+8.6%，赛微微电+6.5%，芯朋微-12.3%，思瑞浦-8%，上海贝岭-7.6%，芯海科技-6.3%，晶丰明源+2.6%。德州仪器公布第二财季营收38.2亿美元，营业利润12.5亿美元，市场预期12.4亿美元；公司预计第三财季营收39.4亿-42.6亿美元，市场预期41.4亿美元。德州仪器首席执行官Haviv Ilan表示，虽然工业和汽车市场继续环比下滑，但所有其他终端市场都在增长，公司对其芯片在工业和汽车市场的长期机会持乐观态度。此外，第二季度在中国的业务增长了约20%。建议关注中国区模拟芯片需求增长。

| **射频**：本周射频板块仍在回调，卓胜微-6.5%，唯捷创芯-7.8%，慧智微-6.1%，康希通信-10.8%。Q2中国大陆安卓链走强，建议关注射频前端IC设计公司中报业绩。

| **功率**：本周功率板块整体股价下行，新洁能-13.8%，斯达半导-5.7%，华润微-3.1%。我们对功率板块维持此前观点，低压功率器件需求率先触底企稳，而高压功率器件预计后续企稳。

| **设备**：本周设备板块整体下跌。当前设备龙头公司的估值回调至底部位置。根据Wind一致预期，北方华创24-25年PE分别为31/23x，华海清科分别为32/24x，盛美上海分别为34/26x。展望后续，国内存储厂预计仍有较大规模的规划扩产产能，而先进逻辑扩产空间也广阔。我们坚定看好设备龙头公司当前低估机会。

| **制造**：本周制造板块整体下跌，中芯国际和华虹公司分别-2.8%、-6.0%。我们认为晶圆制造板块近期回调不改稼动率修复的趋势。TechInsights近期预计，2024年下半年全球晶圆厂利用率有望达到80%左右。建议关注中芯、华虹以及晶合集成机会。

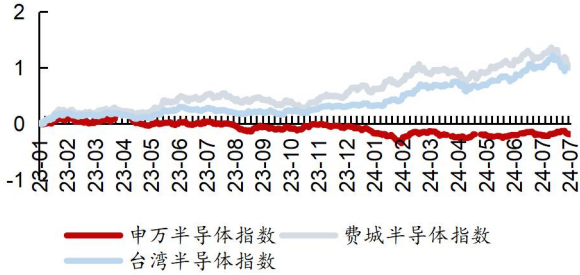
| **封测**：本周封测板块表现分化，伟测科技+4.1%，长电科技-8.3%，通富微电-7.6%。近期长电微电子晶圆级微系统集成高端制造项目（一期）完成了规划核实工作，后续将正式竣工投产。预计长电微电子的投产将增强长电在先进封装领域的实力。

➤ **本月关注组合**：北方华创、华海清科、晶晨股份、乐鑫科技、恒玄科技、芯源微、寒武纪、海光信息、龙芯中科、澜起科技、长电科技、中科蓝讯。

➤ **风险提示**

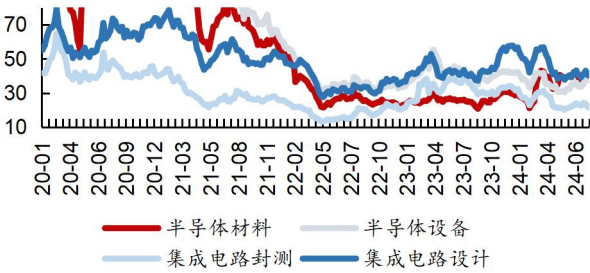
技术发展及落地不及预期；下游终端出货不及预期；下游需求不及预期；市场竞争加剧风险；地缘政治风险；电子行业景气复苏不及预期。

图表 1: 半导体指数涨跌幅



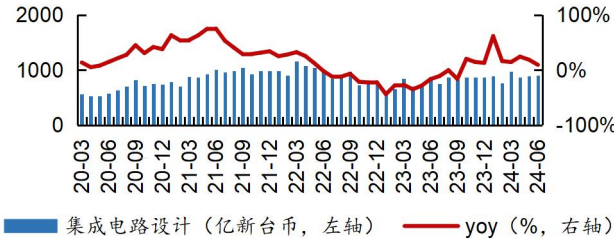
来源: iFinD, 华福证券研究所  
注: 指数涨跌幅以 2023/1/3 日为基期

图表 3: 半导体细分板块估值



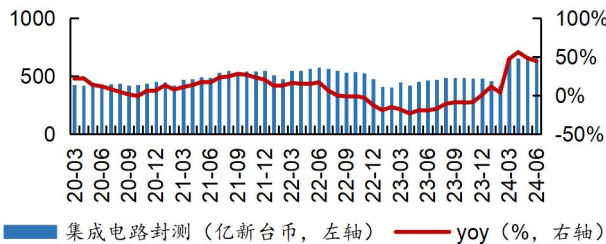
来源: iFinD, 华福证券研究所  
注: 图中数据为长江三级指数市盈率 (PE), 其中预测净利润选取次年 (FY2) 数据

图表 5: 台股月度营收数据 | 集成电路设计



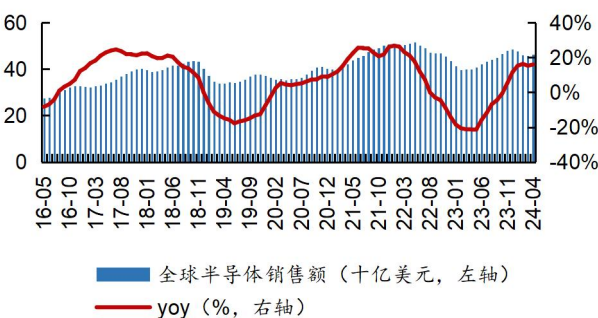
来源: Wind, 华福证券研究所

图表 7: 台股月度营收数据 | 集成电路封装测试



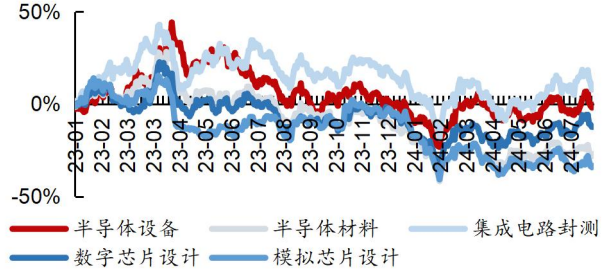
来源: Wind, 华福证券研究所

图表 9: SIA 全球半导体销售额及增速



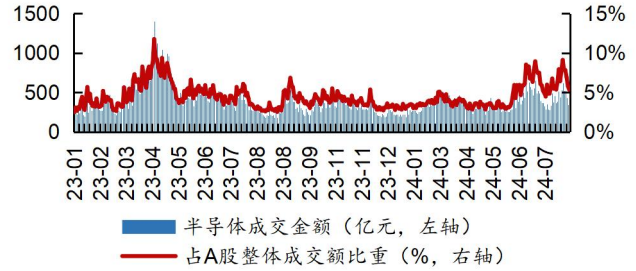
来源: Wind, 华福证券研究所

图表 2: 半导体指数涨跌幅 | 分板块



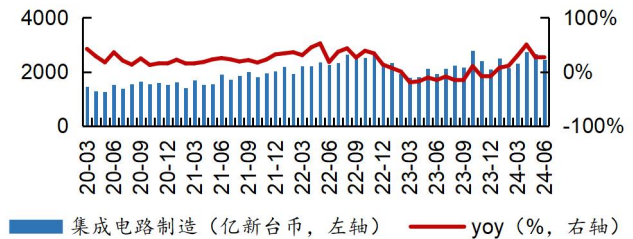
来源: iFinD, 华福证券研究所  
注: 指数涨跌幅以 2023/1/3 日为基期; 图中数据选取申万三级行业指数

图表 4: 半导体成交额及 A 股整体成交额占比



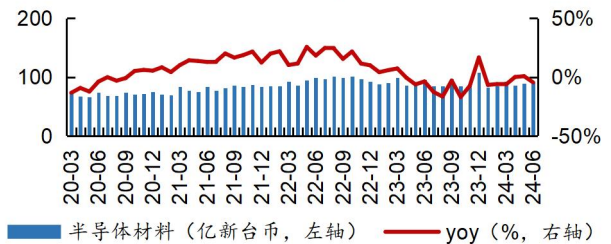
来源: iFinD, 华福证券研究所  
注: 半导体成交额选取图 3 指数加和, A 股整体成交额选取同花顺全 A (沪深京) 指数

图表 6: 台股月度营收数据 | 集成电路制造



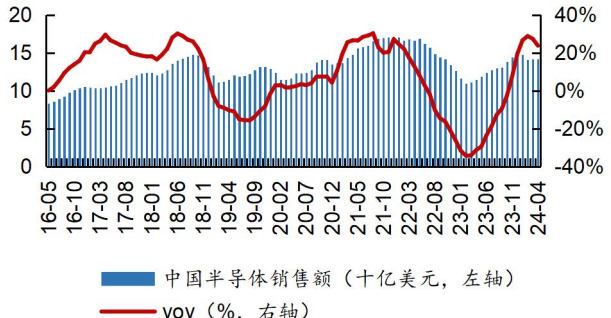
来源: Wind, 华福证券研究所

图表 8: 台股月度营收数据 | 半导体材料



来源: Wind, 华福证券研究所

图表 10: SIA 中国半导体销售额及增速



来源: Wind, 华福证券研究所



## 分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

## 一般声明

华福证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，该等公开资料的准确性及完整性由其发布者负责，本公司及其研究人员对该等信息不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，之后可能会随情况的变化而调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价，也不构成对所述金融产品、产品发行或管理人作出任何形式的保证。在任何情况下，本公司仅承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告以供投资者参考，但不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。投资者应自行决策，自担投资风险。

本报告版权归“华福证券有限责任公司”所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

## 特别声明

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

## 投资评级声明

类别	评级	评级说明
公司评级	买入	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在 20%以上
	持有	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于 10%与 20%之间
	中性	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-10%与 10%之间
	回避	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-20%与-10%之间
	卖出	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在-20%以下
行业评级	强于大市	未来 6 个月内，行业整体回报高于市场基准指数 5%以上
	跟随大市	未来 6 个月内，行业整体回报介于市场基准指数-5%与 5%之间
	弱于大市	未来 6 个月内，行业整体回报低于市场基准指数-5%以下

备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）

## 联系方式

华福证券研究所 上海

公司地址：上海市浦东新区浦明路 1436 号陆家嘴滨江中心 MT 座 20 层

邮编：200120

邮箱：hfjys@hfzq.com.cn